

<<袖珍表面组装技术>>

图书基本信息

书名：<<袖珍表面组装技术>>

13位ISBN编号：9787111208693

10位ISBN编号：7111208692

出版时间：2007-4

出版时间：机械工业出版社

作者：宣大荣,宣大荣 编

页数：382

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<袖珍表面组装技术>>

内容概要

《袖珍表面组装技术工程师使用手册》内容包括：元器件使用参数、元器件焊区设计、电路基板性能参数、贴装材料性能要求、印刷工艺要求、无铅焊料应用参数、焊接/清洗工艺要求、检测/设备维护要求、组装故障分析与对策技巧等。

书中对相关公司/企业的从事SM（表面组装技术）的专业技术人员技能的考量评定，也作了系统详实的说明，并列出了不同的测定试卷。

本手册是从事SMT的工程技术人员必备的工具书，也可作为相关专业大中院校师生的参考指导用书。

<<袖珍表面组装技术>>

书籍目录

前言第1章表面贴装技术和元器件 (SMT/SMC·SMD) 1.1SMT的组成1.2SMD具备的基本条件1.3表面贴装电阻和电容识别标记1.4表面贴装元器件技术性能参数1.5SMD的包装规定与要求1.6表面贴装集成电路材料性能要求1.7SMD使用时的注意事项1.8表面贴装元器件各种试验要求1.9SMT生产现场的防静电要求第2章基板与图形2.1表面贴装对PCB的要求2.2表面贴装用电路板性能2.3PCB设计尺寸的规定2.4表面贴装PCB的力学性能2.5表面贴装元件的焊区设计2.6PCB的整板与子板的拼板原则与要求2.7PCB图形制作要求2.8不同表面贴装集成电路的间距和电场强度关系2.9对不同绝缘材料上的银电极施行的迁移试验2.10在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求2.11BGA的IPC标准规范参数(IPC-7095、IPC-7525) 2.12SMD、BGA模板开口尺寸规范(IPC-7525) 第3章表面贴装用材料3.1贴片胶3.1.1贴片胶选择基准3.1.2贴片胶涂敷工艺要求3.1.3贴片胶固片后粘合强度值3.1.4贴片胶粘接力测定法3.1.5贴片胶扩展率测定法3.1.6贴片胶使用上的注意事项3.2焊膏与印制3.2.1焊膏的选择要求3.2.2焊膏品种与特性3.2.3焊膏特性和贴装电路引线间距的关系3.2.4焊膏用助焊剂的分类3.2.5影响焊膏印制性能的各种因素3.2.6对焊膏印制性能产生影响的各种因素3.2.7焊膏的粒径与脱膜性、焊料球的关系3.2.8对焊膏的要求特性和相关因素3.2.9焊膏合金粉末尺寸规定和分类3.2.10焊膏的粘度、触变系数与印制性能的关系3.2.11焊膏粉末粒子直径和氧化物体积的关系3.2.12焊膏合金粉末粒子(球形)直径和氧化物厚度与比例的关系3.2.13焊膏在印制时的厚度和再流后的厚度变化3.2.14焊膏印制时间同温度的关系3.2.15焊膏印制时间同湿度的关系3.2.16焊膏高精度印制工艺条件3.2.17常用不同丝网材料性能比较3.2.18金属网板的常用标准尺寸3.2.19由SOP、QFP的不同引线间距设定焊膏印制用金属丝网开口尺寸3.2.20印制丝网的几何特性3.2.21网板开孔形状与焊料球发生数的关系3.2.22焊膏使用时的注意事项3.2.23免清洗焊膏特征和使用性能3.3SMT用焊料3.3.1表面贴装焊接对焊料的特性要求3.3.2焊料选用的注意事项3.3.3Sn和Pb的物理特性3.3.4表面贴装用Sn-Pb焊料的标准状态图3.3.5Sn-Pb系焊料的物理特性3.3.6Sn-Pb系焊料特征性能3.3.7焊料合金的蠕变特性3.3.8表面贴装用焊料的疲劳寿命比较3.3.9不同焊料的疲劳寿命比较3.3.10对60Sn-40Pb焊料添加各种元素给润湿时间产生的影响.....第4章焊接/清洗第5章检测/贴装/设备维护第6章故障分析与对策技巧附录参考文献

<<袖珍表面组装技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>